

PCN#20141223000
VSSOP パッケージ 一部製品 Cu(銅)ワイヤ追加認定

お客様各位

今回のお知らせは、変更実施についての **final** 版の連絡になります。変更の詳細は、次頁以降をご参照下さい。

本通知は、いかなる製品の製造終了に関する状況を変更するものではありません。既に製造終了の連絡をさせていただいている場合には、本通知によって、既通知の最終受注日及び最終出荷日が延長されることはありません。

変更品の出荷につきましては、お客様との早期変更実施の個別契約を締結している場合を除いては、本通知発行日より **30** 日以降に予定いたしております。この通知期間は、弊社品質標準に基づいております。本変更に対するお客様個別のご要求に関しましては、個別契約にて承ります。弊社と合意済みの個別要求につきましては、別途対応させていただきます。担当営業にご確認下さい。

尚、ご不明な点、ご質問等がございましたら、担当営業或いは pcn_tij@list.ti.com にお問い合わせ下さい。

以上

PAGE 2:

Attachment: 1

本通知は、通知日前 24 ヶ月以内に本変更対象製品をご購入いただいたお客様に連絡させていただいております。変更内容詳細は下記を参照ください。

PCN 番号:	20141223000	PCN 日付:	12/23/2014
表題:	VSSOP パッケージ 一部製品 Cu(銅)ワイヤ追加認定		
PCN 詳細			
変更内容:			
<p>VSSOP パッケージ一部製品について、追加 bond material として Cu(銅)ワイヤを認定します。本通知は、PCN20130523003 (2013 年 6 月 7 日発行) 及び PCN20140212002 (2014 年 2 月 17 日発行) の extension になります。本通知の対象製品は、旧 National Semiconductor 社 PCN system より発行された Forecast PCN20125301A (2012 年 7 月 31 日発行) もしくは Forecast PCN20123202A (2012 年 3 月 17 日発行) に含まれておりました。</p>			
	From	To	
Wire	Au, 0.9mil & 1.0mil	Cu, 0.96 mil or Au, 1.0mil	
変更理由:			
<p>供給能力確保</p> <p>1) 業界技術動向に合わせて、向上した機械的/電気的特性のワイヤを使用します。</p> <p>2) 組立/検査量産サイトの柔軟性を最大限にします。</p> <p>3) Cu(銅)は、入手及び保管がより容易になります。</p>			
外観, 寸法, 機能, 品質, 信頼性(positive/negative)に関する懸念事項:			
なし			

注記)

1. 本資料は英語原文(一部)の日本語訳になりますが、TI の公式文書はあくまで英語原文になります。英語原文と日本語訳に齟齬がある場合には、英語原文が優先されます。
2. 上記項目以外、本資料に日本語訳が記載されていない項目については英語原文を参照ください。

原文のみ記載の項目例:

- **Proposed 1st Ship Date** (変更品出荷開始予定日)
- **Last date to order/Last date to ship** (最終受注日/最終出荷日)
- **Estimated Sample Availability** (サンプル入手可能予定時期)
- **Change Type** (変更項目タイプ)
- **Changes to product identification resulting from this PCN** (本変更による製品識別の変更)
- **Product Affected** (対象製品)
- **Qualification Data** (認定試験データ)
- **Appendix** (付属資料) 等